

## **Memorial Técnico**

**Modelo:** MV-9DL

**Marca:** Mirtec Co., Ltd.

### **Descrição técnica:**

Máquina de Inspeção Ótica Automática (AOI) de placas de circuito impresso. Composto por sistema de transporte do produto com ajuste automático de largura, capaz de disponibilizar dois produtos, um na parte frontal e outro na parte traseira da máquina, para que seja inspecionado um de cada vez, sem a necessidade de espera na carga e descarga do produto entre a inspeção de cada produto. São montados no sistema de transporte, sensores óticos para reconhecimento do produto dentro da máquina. O sistema de transporte de entrada e saída da máquina se comunica com os outros equipamentos através de interface SMTA. Com um módulo de 1 câmera ortogonal com resolução de 15 Mega Pixel (em configuração standard) e um módulo de 4 câmeras posicionadas em ângulo com resolução de 18 Mega Pixel (em configuração standard). A máquina possui dois eixos lineares onde os módulos das câmeras são fixados para que sejam posicionados sobre o produto para a aquisição das imagens. Em cada módulo das câmeras é montado um domo de iluminação para que cada componente eletrônico do produto, a ser inspecionado, seja iluminado durante o processo de aquisição das imagens. As imagens são adquiridas por placas de capturas e enviadas para o microcomputador da máquina. O Microcomputador processa as imagens e através de um aplicativo próprio do fabricante que avalia as condições de montagem e soldagem de cada componente eletrônico montado no produto. Este aplicativo é capaz de detectar falhas na montagem como: falta de solda, excesso de solda, curto de solda, falta de componente, deslocamento de componentes, montagem com polaridade invertida, terminal de componente levantado, componente montado de ponta cabeça. Junto com o computador da máquina, também acompanham monitor, teclado e mouse, para o usuário seja capaz de executar a carga, criação e depuração dos programas. O resultado da análise do produto é enviado para a próxima operação com o detalhamento de cada componente do produto inspecionado.

### **Aplicação:**

Inspeção de componentes eletrônicos, pós-solda, detecta defeitos como componentes levantados, pontes de solda, solda insuficiente ou excessiva, e desalinhamentos após o processo de soldagem. Inspeccionar componentes pequenos, como chips 0402 e 01005, garantindo a detecção de defeitos em montagens de alta densidade.

### **Especificações técnicas:**

Dimensões: 1710x1500x1640

Interface: SMTA

Alimentação pneumática: 6 bar

Voltagem (V): 220

Potência: 0,53 kW

Frequência (Hz): 50/60

**Fotos:**

